（上接A74版）

（2）主营业务收入分按地区构成

项目	2020年1-9月		2019年		2018年		2017年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
国内	344,271.65	24.69	344,822.59	25.37	311,823.03	32.25	138,202.96	57.47
国外	1,049,954.37	75.31	1,014,563.06	74.63	655,146.56	67.75	101,428.14	42.23
合计	1,394,226.02	100.00	1,359,385.65	100.00	966,969.59	100.00	239,631.11	100.00

报告期内，公司产品以外销为主，外销占比分别为42.33%、67.75%、74.63%和75.31%，公司主营业务收入分地区结构保持稳定。

2、主营业务收入变动分析

报告期内，公司主营业务收入分别为239,631.11万元、966,969.59万元、1,359,385.65万元和1,394,226.02万元。2018年和2019年分别较上年增长303.52%和40.58%。报告期内，公司主营业务收入变动情况如下：

项 目	2020年1-9月	2019年		2018年		2017年
	金额（万元）	金额（万元）	增长率（%）	金额（万元）	增长率（%）	金额（万元）
半导体设计	1,215,845.98	1,135,889.94	71.00	664,256.50	820.87	72,133.19
CMOS图像传感器	1,040,721.21	977,884.96	79.00	546,311.98	—	—
ASIC	29,084.90	42,896.52	59.99	26,811.79	—	—
LCOS	2,053.96	2,958.41	-10.10	3,290.65	—	—
Camera Cube Chip	4,812.18	16,749.21	329.99	3,886.24	—	—
TDDI	51,722.00	—	—	—	—	—
TVS	36,668.89	42,126.17	6.22	39,660.42	5.19	37,706.13
MOSFET	11,278.18	11,990.16	-3.00	12,361.26	8.32	11,411.63
玛特基	2,227.80	3,435.82	18.86	2,890.81	16.03	2,491.54
IC	27,371.88	23,541.32	19.49	19,701.25	38.07	14,585.75
射频及微传感	8,979.14	9,248.56	31.23	7,047.67	137.84	2,963.23
卫星直播芯片	149.12	856.52	-34.74	1,311.06	-47.86	2,514.53
其他	1,779.71	4,203.27	331.34	974.46	111.19	461.40
半导体分销	178,399.04	223,496.71	-26.17	302,713.09	80.73	167,497.92
合 计	1,394,226.02	1,359,385.65	40.58	966,969.59	303.52	239,631.11

（1）半导体设计收入变动分析

2017-2019年，公司半导体设计收入分别为72,133.19万元、664,256.50万元和1,135,889.94万元，2018年和2019年分别较上年增长820.87%和71.00%。2018年4月，豪威科技纳入公司合并报表范围，公司半导体设计业务收入大幅增长。豪威科技作为去全球CMOS图像传感器行业三家龙头企业之一，随着全球CMOS图像传感器市场规模的不断扩大，凭借优秀的研发能力、全面的产品线、稳定的产品质量和快速的市场应变能力，销售收入稳步增长。

2020年1-9月，公司半导体设计收入为1,215,845.98万元，同比增长42.69%，主要原因有：第一，手机摄像头市场需求快速增长，多摄像头手机成为主流，部分手机厂商的新机型已搭载五摄、六摄甚至七摄，且单位摄像头的价值量快速提升；第二，2019年6月，豪威科技先后发布首款0.8微米3200万像素和0.8微米4800万像素图像传感器，该产品采用豪威科技的PureCel?Plus晶片堆叠技术，可为主流智能手机提供一流的静态图像和视频捕捉，技术水平全球领先，产品市场需求大幅增长，公司备货及销量大幅增长。

（2）半导体分销收入变动分析

2017-2019年，公司半导体分销收入分别为167,497.92万元、302,713.09万元和223,495.71万元，2018年较上年增长80.73%，公司不断丰富代理的产品线类型，新客户开发取得突破。同时，2018年，公司抓住市场紧缺产品价格上涨的时机，积极扩大客户市场领域，在工业设备、安防电子等市场有明显突破。

2019年，半导体分销收入较上年下降26.17%，主要原因是一方面受中美贸易战带来的不稳定因素影响，部分下游客户表现出观望态度，采购行为偏向保守；另一方面，受下游终端出货量下降影响，公司分销收入有所下降。

长期以来，公司通过清晰的产品和市场定位，构建了稳定、高效的分销模式，形成差异化竞争优势，分销业务是设计业务了解市场需求的重要信息来源，在保持现有半导体分销业务产品线和销售规模的背景下，公司更多地将通过代理产品类型、丰富客户群及产品应用领域的方式助力半导体设计业务迅速发展。

（二）营业成本分析

报告期内，公司营业成本分别为191,185.28万元、734,676.59万元、989,770.81万元和971,447.46万元，整体呈上升趋势，与营业收入的变动趋势基本一致。具体营业成本分类情况如下：

项目	2020年1-9月		2019年		2018年		2017年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
主营业务成本	971,009.75	99.95	988,329.26	99.85	733,963.56	99.90	190,907.97	99.85
其他业务成本	437.71	0.05	1,441.54	0.15	713.03	0.10	277.31	0.15
合计	971,447.46	100.00	989,770.81	100.00	734,676.59	100.00	191,185.28	100.00

报告期内，公司主营业务成本分别为190,907.97万元、733,963.56万元、988,329.26万元和971,009.75万元，占营业成本的比例分别为99.85%、99.90%、99.85%和99.95%，占比较高，与主营业务收入占比相匹配。

报告期内，公司主营业务成本分产品构成情况如下：

项 目	2020年1-9月		2019年		2018年		2017年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
半导体设计	824,216.19	84.88	783,424.72	79.27	496,266.07	67.61	47,471.40	24.87
CMOS图像传感器	697,635.17	71.85	676,512.89	68.45	415,566.15	56.62	—	—
ASIC	16,612.18	1.71	28,464.60	2.88	15,306.04	2.09	—	—
LCOS	1,472.47	0.15	3,521.26	0.36	4,606.01	0.63	—	—
Camera Cube Chip	2,496.30	0.26	13,650.20	1.38	5,397.49	0.74	—	—
TDDI	46,299.12	4.72	—	—	—	—	—	—
TVS	22,773.42	2.35	25,908.27	2.62	25,107.77	3.42	24,690.82	12.93
MOSFET	7,851.32	0.81	7,565.03	0.77	6,898.30	0.93	7,638.98	4.00
玛特基	1,193.95	0.12	2,090.13	0.21	1,848.52	0.25	1,710.44	0.90
IC	17,931.18	1.85	15,978.46	1.62	13,416.44	1.83	8,222.32	4.31
射频及微传感	8,840.28	0.91	8,722.69	0.88	6,973.68	0.95	3,127.78	1.64
卫星直播芯片	130.20	0.01	752.73	0.08	1,082.76	0.15	2,023.18	1.06
其他	1,481.61	0.15	268.26	0.03	103.91	0.01	57.88	0.03
半导体分销	146,793.56	15.12	204,904.54	20.73	227,697.49	32.39	143,436.57	75.13
合 计	971,009.75	100.00	988,329.26	100.00	733,963.56	100.00	190,907.97	100.00

2018年以来，CMOS图像传感器设计成本和半导体分销成本占公司主营业务成本超过85%，与公司收入结构相匹配。

（三）毛利率分析

1、主营业务毛利变动分析

报告期内，公司分产品的主营业务毛利情况如下：

项 目	2020年1-9月		2019年		2018年		2017年	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
半导体设计	391,629.79	92.54	352,465.21	94.99	167,990.43	72.10	24,661.79	50.62
CMOS图像传感器	343,086.04	81.07	301,372.07	81.22	130,745.83	56.11	—	—
ASIC	12,472.73	2.95	14,441.91	3.89	11,505.75	4.94	—	—
LCOS	581.49	0.14	-562.85	-0.15	-1,314.36	-0.56	—	—
CameraCubeChip	2,316.88	0.55	3,099.01	0.84	-1,509.25	-0.64	—	—
TDDI	5,922.88	1.40	—	—	—	—	—	—
TVS	12,892.47	3.05	16,217.80	4.37	14,552.65	6.25	13,014.31	26.71
MOSFET	3,426.86	0.81	4,425.13	1.19	5,502.97	2.36	3,772.65	7.74
玛特基	1,033.85	0.24	1,345.69	0.36	1,042.29	0.45	781.10	1.60
IC	9,440.70	2.23	7,562.86	2.04	6,284.81	2.70	6,363.41	13.06
射频及微传感	138.87	0.03	525.96	0.14	73.99	0.03	-164.56	-0.34
卫星直播芯片	18.92	0.00	102.79	0.03	228.23	0.10	491.36	1.01
其他	298.10	0.07	3,934.92	1.06	870.55	0.37	403.53	0.83
半导体分销	31,586.48	7.46	18,591.17	5.01	68,015.60	27.90	24,061.38	49.38
合 计	423,216.27	100.00	371,056.39	100.00	233,006.03	100.00	48,723.14	100.00

报告期内，公司主营业务毛利金额分别为48,723.14万元、233,006.03万元、371,056.39万元和423,216.27万元，毛利金额主要来自于CMOS图像传感器、ASIC、TVS、IC、TDDI和半导体分销。

2、主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务毛利率变动情况如下：

项 目	2020年1-9月		2019年		2018年		2017年
	毛利率（%）	变动百分比	毛利率（%）	变动百分比	毛利率（%）	变动百分比	毛利率（%）
半导体设计	32.21	1.18	31.03	5.74	25.29	-8.90	34.19
CMOS图像传感器	32.97	2.15	30.82	6.89	23.93	—	—
ASIC	42.88	9.21	33.67	-9.24	42.91	—	—
LCOS	28.31	47.34	-19.03	20.91	-39.94	—	—
CameraCubeChip	48.15	29.65	18.50	57.07	-38.57	—	—
TDDI	11.46	—	—	—	—	—	—
TVS	36.15	-2.28	38.50	1.81	36.69	2.18	34.52
MOSFET	30.38	-6.53	36.91	-7.61	44.52	11.46	33.06
玛特基	46.41	7.24	39.17	3.11	36.06	4.71	31.35
IC	34.49	2.36	32.13	0.23	31.90	-11.73	43.63
射频及微传感	1.55	-4.14	5.69	4.64	1.05	6.60	-5.55
卫星直播芯片	12.69	0.67	12.02	-5.39	17.41	-2.13	19.54
其他	16.75	-76.87	93.62	4.28	89.34	1.88	87.46
半导体分销	17.71	9.39	8.32	-13.16	21.48	7.11	14.37
综合毛利率	30.35	3.06	27.30	3.20	24.10	3.76	20.33

报告期内，公司主营业务毛利率分别为20.33%、24.10%、27.30%和30.35%。

（1）半导体设计业务

报告期内，公司半导体设计业务毛利率分别为34.19%、25.29%、31.03%和32.21%。

2018年，豪威科技纳入公司合并报表范围，CMOS图像传感器成为公司主要产品，2018年、2019年和2020年1-9月，CMOS图像传感器的收入占设计业务收入的比例分别为82.24%、86.09%和85.60%，其毛利率波动对设计业务整体毛利率影响较大。

2019年和2020年1-9月，半导体设计业务毛利率分别为31.03%和32.21%，较上年分别提高5.74和1.18个百分点，主要得益于CMOS图像传感器产品毛利率的提高。在2017年及以前较长一段时间内，豪威科技产品型号繁多，产品线基本覆盖了CMOS图像传感器下游全部领域。这种经营策略虽然有助于豪威科技增加产品出货量，提高市场占有率，但产品线过于冗长一方面分散了研发、设计部门的精力，另一方面上有供应链被大量毛利率较低的低端产品占用，影响了其盈利能力。2017年9月，韦尔股份董事长虞仁荣先生担任豪威科技CEO，对豪威科技进行了经营战略和产品结构调整，主动收缩产品线，战略性放弃了部分毛利率较低的产品，并将市场开拓、技术研发、产品设计等方面的资源向智能手机、安防监控、汽车、医疗、AR/VR五大领域的重点产品集中，由此带来2018年以后毛利率水平的持续大幅提高。

（2）半导体分销业务

报告期内，半导体分销业务毛利率分别为14.37%、21.48%、8.32%和17.71%，呈现较大幅度波动。2017年下半年起，受电容电阻供需关系、原材料价格波动影响，公司分销业务中占比最大的电容电阻类产品价格先后经历连续大幅上涨、大幅下跌走势，导致公司半导体分销业务毛利率2018年达到21.48%，2019年又下降至8.32%。

2020年初，受5G智能手机需求带动，电容电阻原厂库存降低，价格再度出现大幅上涨，公司前三季度分销业务毛利率较2019年提高9.39个百分点。

（3）主营业务毛利率与同行业对比

单位：%

公司简称	2020年1-9月注	2019年	2018年	2017年
可比公司平均数	29.15	29.56	29.87	30.98
可比公司中位数	27.07	27.27	27.31	28.00
韦尔股份	30.46	27.30	24.10	20.33

数据来源：东方财富Choice数据。

注："注营业务收入"科目2018年起单独列示，故2017年无统计数据，不做比较。

公司收入主要来自芯片设计，销售费用、管理费用主要为职工薪酬及固定支出，这些费用相对较为固定，并不随营业收入增长而大幅增加。2018年、2019年和2020年1-9月，公司分别实现营业收入97.02亿元、136.32亿元和139.69亿元，远高于同行业可比上市公司平均数63.07亿元、67.79亿元、50.09亿元和中位数12.80亿元、14.78亿元、10.85亿元，因此销售费用率低于同行业可比上市公司平均数及中位数，管理费用率介于同行业可比上市公司平均数及中位数之间。

从产品结构来看，2018年、2019年和2020年1-9月，CMOS图像传感器的收入占设计业务收入的比例分别为82.24%、86.09%和85.60%，作为技术领先的全球第三大CMOS图像传感器设计企业，公司十分注重自主知识产权和新产品的研发，研发投入逐年增长，研发费用占营业收入的比例分别为8.40%、9.41%和18.80%，高于同行业可比上市公司平均数和中位数。

2018年、2019年和2020年1-9月，公司股权收购以及销售规模扩大增加了资金需求，向金融机构的长短期借款增加，财务费用相应增加，财务费用率高于同行业可比上市公司平均数和中位数。

（五）其他收益

报告期内，公司其他收益分别为739.83万元、682.85万元、1,050.73万元和1,569.28万元，主要为政府补助，具体如下：

单位：万元

项 目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
政府补助	1,523.27	1,019.13	637.26	739.83
进项税加计抵减	9.69	2.76	—	—
代扣个人所得税手续费	36.32	28.84	45.59	—
合 计	1,569.28	1,050.73	682.85	739.83

（六）公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益分别为0万元、-67.33万元、6,053.84万元和10,753.91万元，具体如下：

单位：万元

项 目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
交易性金融资产	133.00	257.00	—	—
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	—	—	-67.33	—
其他非流动金融资产	10,620.91	5,796.84	—	—
合 计	10,753.91	6,053.84	-67.33	—

公司根据银信资产评估有限公司于2020年3月31日出具的《上海韦尔半导体股份有限公司拟了解所持有的青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）金融工具市场价值估值报告》（银信咨报字（2020）沪第078号）的估值结果，该金融资产采用第二层次公允价值计量，即根据市场公开报价考虑流动性风险后确定计量项目的公允价值，金融资产公允价值为8,415.00万元，据此确认公允价值变动损益5,796.84万元。

（七）信用减值损失及资产减值损失分析

根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕16号）相关规定，公司2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则，2019年，公司按照预期信用损失法计提应收票据、应收账款和其他应收款减值损失，减值损失在"信用减值损失（损失以"-"号填列）"科目列示。

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项 目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
应收票据坏账损失	84.12	57.85	—	—
应收账款坏账损失	8,754.87	6,218.58	—	—
其他应收款坏账损失	70.62	103.09	—	—
合 计	8,909.61	6,379.52	—	—

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

项 目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
坏账损失	—	—	2,850.82	1,421.41
存货跌价损失	16,977.86	22,208.94	24,758.64	909.34
研发费本化损失	1,574.81	2,314.56	—	—
预付账款损失	—	344.25	—	—
合 计	18,552.66	24,867.74	27,609.46	2,330.75

1、坏账损失

报告期内，公司坏账损失分别为1,421.41万元、2,850.82万元、6,379.52万元和8,909.61万元，主要为对应收票据、应收账款和其他应收款按会计政策计提的减值准备。随着公司业务规模扩大，应收账款余额保持增长，坏账准备计提金额相应增加，但占各期应收账款余额的比例很低。

2、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失（2017年、2018年合坏账损失）分别为2,330.75万元、27,609.46万元、24,867.74万元和18,552.66万元，主要为存货跌价损失。其中，存货跌价损失分别为909.34万元、24,758.64万元、22,208.94万元和16,977.86万元。报告期内，公司根据存货会计政策，按成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。

2018年、2019年，公司存货跌价损失金额增长较大，主要系将豪威科技纳入合并报表范围。2017年起，豪威科技管理层积极实施产品升级策略，精简产品线、降低低端产品占比，集中精力研发和推广技术附加值较高的高端产品。在这种情况下，部分低端产品预计销售量下降导致存货跌价准备计提金额增加。

2019年，公司研发资本化损失2,314.56万元，主要系豪威科技研发2,400万像素CMOS产品2018年4月由开发支出转入无形资产，但先后发布首款0.8微米3,200万像素和0.8微米4,800万像素图像传感器，产品市场需求大幅增长，预计2,400万像素产品不再具有市场空间，对相关无形资产计提了损失。

（八）营业外收支

1、营业外收入

报告期内，公司营业外收入明细如下：

单位：万元

项 目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
政府补助	962.61	461.22	367.68	17.00
违约金及赔款收入	347.48	46.01	10.06	74.09
取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	—	—	111.36
业绩补偿款	—	—	—	1,179.88
客户补偿金	3,430.96	—	—	—
其他	83.23	48.84	60.15	41.78
合 计	4,844.19	556.07	437.86	1,424.11

报告期内，公司营业外收入分别为1,424.11万元、437.86万元、555.07万元和4,844.19万元，主要为政府补助。

2017年，营业外收入中的业绩补偿款为1,179.88万元，系2014年7月公司收购北京泰合志恒科技有限公司100%的股权，向其股东北京泰利湃思科技有限公司、武汉天喻信息产业股份有限公司、上海益都实业投资有限公司及其他四位自然人股东李群、邢观斌、毛昕、崔松涛支付合并对价6,000万元。按照投资协议北京泰合志恒科技有限公司应在2014年6-12月、2015年、2016年的合计净利润分别不低于人民币-500万元、-100万元、900万元人民币，否则原股东李群、邢观斌、毛昕、崔松涛应补偿公司上述利润未完成部分的差额，2016年按投资协议计算应收取补偿款1,179.88万元，2017年公司收到上述补偿款。

2、营业外支出

报告期内，公司营业外支出明细如下：

单位：万元

项 目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
固定资产报废损失	148.62	100.70	28.08	—
捐赠	—	—	10.00	—
罚款滞纳金	0.39	3.81	9.64	0.08
赔款支出	349.09	170.62	113.75	97.39
诉讼和解金	—	337.37	2,041.38	—
其他	92.49	7.31	7.75	0.82
合 计	590.60	619.81	2,210.61	98.29

报告期内，公司营业外支出分别为98.29万元、2,210.61万元、619.81万元和590.60万元。2018年，营业外支出金额相对较高，主要为美国豪威向Collabo Innovations, Inc.和IP Bridge支付的诉讼和解金。Collabo Innovations, Inc.和IP Bridge未实际从事经营业务，其主要业务是以自己拥有或获得授权的专利权对其他公司提起专利权诉讼，不具备CMOS图像传感器业务运营能力，亦未向任何客户销售过CMOS图像传感器产品。

（九）非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益及对经营成果的影响情况如下：

单位：万元

项 目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
归属于母公司股东非经常性损益净额	14,036.47	13,143.06	1,243.81	1,684.93
归属于母公司股东的净利润	172,467.34	46,563.22	14,489.19	13,715.63
占归属于母公司股东的净利润的比例	8.13%	28.23%	8.58%	12.10%
扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润	158,430.86	33,420.17	13,245.38	12,030.70

2017年，公司非经常性损益占归属于母公司股东的净利润的比例为12.10%，主要系收到业绩补偿款1,179.88万元。2019年，公司非经常性损益占归属于母公司股东的净利润的比例为28.23%，主要系同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益和青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）权益工具的公允价值变动损益所致。

公司非经常性损益明细表见本募集说明书摘要之"第四节 财务会计信息/四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表"。

（十）纳税情况

报告期内，公司及子公司主要税种税率情况如下：

税 种	计税依据	税 率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，抵顶部分为应交增值税	3.00~25.00%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1.00~7.00%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0.00~33.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的税率情况如下：

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海韦尔微电子有限公司、合肥韦豪半导体技术有限公司、上海韦久微电子有限公司、无锡中普微电子有限公司、上海韦功微电子有限公司、无锡尔华半导体有限公司、上海图云半导体有限公司、武汉韦尔半导体有限公司、武汉韦尔投资管理有限公司、上海高易半导体有限公司、绍兴韦豪半导体科技有限公司、深圳市芯慧投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司、绍兴豪威半导体有限公司、深圳市欢鸣志电子有限公司、苏州欢鸣志电子有限公司、鸿光电子元件（深圳）有限公司、上海灵心电子科技有限公司、上海树诚电子科技有限公司、北京豪威科技有限公司、北京豪威亦庄科技有限公司、上海全芯半导体技术有限公司、北京视创源科技发展有限公司、浙江韦尔投权投资有限公司、上海韦尔贸易企业有限公司、合肥泰合志恒科技有限公司	25.00
上海韦孜美电子科技有限公司	25.00、21.00
OmniVision Technologies, Inc.	21.00
台湾豪威科技有限公司、台湾豪威国际科技有限公司、台湾豪威光电科技股份有限公司	20.00
韦尔半导体香港有限公司	16.50、20.00
安浦利科技有限公司、香港华清电子（集团）有限公司、香港鸿光兴盛电子有限公司、香港灵心电子科技有限公司、香港东意电子有限公司、香港树伟贸电子科技有限公司、OmniVision Technologies (HongKong) Company Limited、OmniVision Trading (HongKong) Company Ltd.、OmniVision Technologies Development (HongKong) Company Limited、OmniVision Holding (HongKong) Company Limited、思比科（香港）有限公司	16.50
北京泰合志恒科技有限公司、武汉泰合志恒科技有限公司、武汉韦普科技有限公司、北京欢鸣志科技有限公司、深圳市欢鸣志物流有限公司、豪威半导体（上海）有限责任公司、豪威科技（上海）有限公司、豪威光电子科技（上海）有限公司、北京思比科微电子技术股份有限公司、太仓思比科微电子技术有限公司、天津安泰微电子技术有限公司、上海芯仑光电科技有限公司	15.00
上海韦尔半导体股份有限公司、深圳东益电子有限公司、OmniVision Technologies Singapore Pte.Ltd.、豪威科技（武汉）有限公司	10.00

二、现金流量分析

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项 目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
销售商品、提供劳务收到的现金	1,269,703.29	1,293,151.73	1,082,115.43	236,389.46
收到的税费返还	7,351.25	6,842.74	7,503.65	4,938.74
收到其他与经营活动有关的现金	15,954.83	8,430.08	5,443.19	3,088.43
经营活动现金流入小计	1,292,009.37	1,308,424.54	1,095,062.27	244,416.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,094,298.06	1,049,234.52	874,475.86	236,188.87
支付给职工以及为职工支付的现金	108,454.72	125,094.48	90,498.71	13,584.88
支付的各项税费	21,064.00	16,889.26	22,260.71	5,328.38
支付其他与经营活动有关的现金	31,368.49	36,662.77	28,829.33	16,509.93
经营活动现金流出小计	1,256,185.26	1,227,891.02	1,016,064.61	271,612.06
经营活动产生的现金流量净额	37,824.10	80,533.52	79,000.66	-27,195.43

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-27,195.43万元、79,000.66万元、80,533.52万元和37,824.10万元。销售商品、提供劳务收到的现金是公司经营活动现金流入的主要来源。经营活动现金流出主要包括购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金。报告期内，公司销售收入转化为现金流的能力如下：

单位：万元

项 目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
营业收入	1,396,886.88	1,363,167.06	970,190.24	240,589.63
销售商品、提供劳务收到的现金	1,269,703.29	1,293,151.73	1,082,115.43	236,389.46
销售收现比	90.90%	94.86%	111.54%	98.25%

报告期内，公司的销售收现比分别为98.25%、111.54%、94.86%和90.90%，收现能力良好。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项 目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
收回投资收到的现金	51,696.64	974.76	—	—
取得投资收益收到的现金	12.04	10.64	38.24	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	333.28	1,664.28	344.26	208.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	824.48	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	31,079.10	2,189.69
投资活动现金流入小计	51,412.97	3,474.16	31,461.60	2,398.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,968.35	74,331.63	19,987.18	6,133.26
投资支付的现金	30,071.01	10,248.11	144,843.85	2,597.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	138,389.64	81,253.77	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	2,000.00	10,325.38	29,697.40	—
投资活动现金流出小计	240,029.00	176,258.29	194,488.43	8,070.26
投资活动产生的现金流量净额	-188,616.02	-172,784.11	-163,026.84	-5,670.20

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-5,870.20万元、-163,026.84万元、-172,784.11万元和-188,616.62万元。

2018年，投资支付的现金144,843.55万元，主要为收购豪威科技部分股权支付的股权转让款。

2019年，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,331.03万元，主要为购进晶圆重构项目产线相关机器设备以及建筑物设施改造、研发支出资本化、购买图形设计软件使用权；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额81,353.77万元，主要为2019年1月向瑞滇投资管理有限公司支付收购芯能投资、芯力投资各100%的剩余股权转让款。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项 目	2020年1-9月	2019年	2018年	2017年
吸收投资收到的现金	26,444.72	38,000.71	925.00	102,230.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,444.72	348.00	925.00	694.92
取得借款收到的现金	310,510.53	357,222.11	320,281.51	141,849.40
收到其他与筹资活动有关的现金	1,151.65	6,262.57	4,798.85	9,776.34
筹资活动现金流入小计	338,106.90	401,484.39	326,005.36	253,854.79
偿还债务支付的现金	164,369.56	266,481.05	254,964.22	140,923.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,873.93	31,886.49	14,071.28	3,088.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	123.43	59.29	68.13	—
支付其他与筹资活动有关的现金	9,672.18	2,116.13	8,069.29	12,752.20
筹资活动现金流出小计	199,915.66	289,483.67	277,104.79	156,763.79
筹资活动产生的现金流量净额	138,191.24	112,010.72	48,900.66	97,091.00

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为97,091.00万元、48,900.66万元、112,010.72万元和138,191.24 万元，主要系银行借款增加所致。

2017年，公司吸收投资收到的现金102,230.05万元，主要为首次公开发行股票并上市募集的资金以及2017年限制性股票股权激励计划收到的现金。

四、资本性支出分析

（一）报告期内的重大资本性支出情况

报告期内，随着公司业务规模的发展和收购豪威科技、思比科股权以及Synaptics Incorporated的TDDI业务，固定资产、无形资产、在建工程均大幅增长，构成公司资本性支出的主要组成部分。2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，公司投资活动现金流出分别为9,070.26万元、194,488.54万元、176,258.29万元和240,029.00万元。

（二）未来可预见的主要重大资本性支出计划

截至本募集说明书摘要签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要是本次发行可转债募集资金拟投资的项目，本次募集资金投资项目的具体情况详见"第六节 本次募集资金运用"的相关内容。

除上述拟投资的项目外，截至本募集说明书摘要签署之日，公司不存在其他未来 可预见的重大资本性支出计划。

第六节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过244,000万元（含），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

序号	项目	项目投资总额（万元）	已投入金额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	183,919.98	25,058.70	130,000.00
2	CMOS图像传感器研发升级	136,413.84	—	80,000.00
3	补充流动资金	34,000.00	—	34,000.00
合 计		354,333.82	25,058.70	244,000.00

注："已投入金额"为截至2020年9月30日项目已使用募集资金投资的金额。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过前次剩余募集资金（前次剩余募集资金仅用于晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）项目投资）和自筹资金先行投入。若在可转换公司债券预案公告且前次剩余募集资金已使用完毕后，存在以自筹资金预先投入上述项目的情况，在本次募集资金到位后将对预先投入的自筹资金予以置换。

公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金